



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112771663 A

(43) 申请公布日 2021.05.07

(21) 申请号 201880098120.6

(51) Int.Cl.

(22) 申请日 2018.09.29

H01L 23/48 (2006.01)

(85) PCT国际申请进入国家阶段日
2021.03.29

(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/CN2018/108903 2018.09.29

(87) PCT国际申请的公布数据
W02020/062195 ZH 2020.04.02

(71) 申请人 华为技术有限公司
地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

(72) 发明人 杨帆 史洪宾 龙浩晖 王晓岩

(74) 专利代理机构 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274

代理人 申健

(54) 发明名称

一种焊盘、电子器件及其连接结构、阻焊层的制作方法

(57) 摘要

本申请实施例提供焊盘、电子器件及其连接结构、阻焊层的制作方法,涉及电子元件连接技术领域,该焊盘包括焊盘本体以及覆盖于所述焊盘本体上方的阻焊层,沿所述阻焊层的厚度方向形成有用于焊接的通孔,所述通孔的面积小于所述焊盘本体的面积,且所述通孔的面积沿远离所述焊盘本体的方向逐渐增大。

